

2023-2027年中国化学机械抛光深度调研及投资前景预测报告

产品名称	2023-2027年中国化学机械抛光深度调研及投资前景预测报告
公司名称	北京华商纵横信息咨询中心
价格	6000.00/件
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区亚运村四方大厦
联系电话	188-11718743 13621060192

产品详情

第一章 化学机械抛光（CMP）技术相关概述

1.1 CMP技术概述

1.1.1 CMP技术概念

1.1.2 CMP工作原理

1.1.3 CMP材料类型

1.2 CMP设备应用领域分析

1.2.1 硅片制造领域

1.2.2 集成电路领域

1.2.3 先进封装领域

第二章 2021-2023年中国化学机械抛光（CMP）技术发展环境

2.1 政策环境

2.1.1 行业相关支持政策

2.1.2 应用示范指导目录

2.1.3 原材料工业“三品”实施方案

2.2 经济环境

2.2.1 全球经济形势

2.2.2 国内经济运行

2.2.3 工业经济运行

2.2.4 宏观经济展望

2.3 社会环境

2.3.1 人口结构状况

2.3.2 居民收入水平

2.3.3 居民消费结构

2.4 技术环境

2.4.1 CMP技术发展优势

2.4.2 CMP技术发展水平

2.4.3 CMP专利申请数量

2.4.4 CMP专利地域分布

2.4.5 CMP专利竞争格局

2.4.6 CMP重点专利分析

第三章 2021-2023年中国CMP抛光材料行业发展状况

3.1 半导体材料行业发展分析

3.1.1 半导体材料主要细分产品

3.1.2 半导体材料行业发展历程

3.1.3 半导体材料行业发展规模

3.1.4 半导体材料市场构成分析

3.1.5 半导体材料行业发展措施

3.1.6 半导体材料行业发展前景

3.2 CMP抛光材料行业概述

3.2.1 抛光材料组成

3.2.2 抛光材料应用

3.2.3 行业技术要求

3.2.4 行业产业链条

3.3 CMP抛光材料市场发展分析

3.3.1 全球市场发展

3.3.2 行业发展历程

3.3.3 发展

3.3.4 市场结构分布

3.3.5 行业壁垒分析

3.4 CMP抛光液市场发展分析

3.4.1 CMP抛光液主要成分

3.4.2 CMP抛光液主要类型

3.4.3 CMP抛光液行业发展规模

3.4.4 CMP抛光液行业竞争格局

3.4.5 CMP抛光液行业发展机遇

3.4.6 CMP抛光液行业进入壁垒

3.5 CMP抛光垫市场发展分析

3.5.1 CMP抛光垫主要类别

3.5.2 CMP抛光垫主要作用

3.5.3 CMP抛光垫市场需求分析

3.5.4 CMP抛光垫行业市场规模

3.5.5 CMP抛光垫市场销售均价

3.5.6 CMP抛光垫行业竞争格局

3.5.7 CMP抛光垫国产替代进展

3.6 CMP抛光材料行业制约因素

3.6.1 技术封锁阻碍发展

3.6.2 下游认证壁垒高

3.6.3 高端人才紧缺限制

第四章 2021-2023年中国CMP设备行业发展状况

4.1 半导体设备行业发展情况

4.1.1 半导体设备相关介绍

4.1.2 半导体设备政策发布

4.1.3 半导体设备市场规模

4.1.4 半导体设备市场结构

4.1.5 半导体设备竞争格局

4.1.6 半导体设备国产化分析

4.1.7 半导体设备投融资分析

4.1.8 半导体设备发展趋势分析

4.2 全球CMP设备行业发展情况

4.2.1 全球CMP设备市场规模

4.2.2 全球CMP设备区域分布

4.2.3 全球CMP设备企业格局

4.3 中国CMP设备行业发展情况

4.3.1 CMP设备主要构成

4.3.2 CMP设备应用场景

4.3.3 CMP设备市场规模

4.3.4 CMP设备贸易规模

4.3.5 CMP设备主要企业

4.4 CMP设备行业投资风险

4.4.1 市场竞争风险

4.4.2 技术创新风险

4.4.3 技术迭代风险

4.4.4 客户集中风险

4.4.5 政策变动风险

第五章 2021-2023年化学机械抛光（CMP）技术应用领域发展分析——集成电路制造行业

5.1 集成电路制造业概述

5.1.1 集成电路制造基本概念

5.1.2 集成电路制造工艺流程

5.1.3 集成电路制造驱动因素

5.1.4 集成电路制造业重要性

5.2 全球集成电路制造业发展分析

5.2.1 全球集成电路市场规模

5.2.2 全球集成电路市场结构

5.2.3 全球集成电路区域分布

5.2.4 全球集成电路企业格局

5.2.5 全球晶圆制造市场分析

5.3 中国集成电路制造业发展分析

5.3.1 集成电路制造市场规模

5.3.2 集成电路制造区域布局

5.3.3 集成电路制造设备发展

5.3.4 集成电路制造行业壁垒

5.3.5 集成电路制造发展机遇

5.4 晶圆代工业市场运行分析

5.4.1 全球晶圆代工市场规模

5.4.2 全球晶圆代工新建工厂

5.4.3 全球晶圆代工竞争格局

5.4.4 中国晶圆代工市场规模

5.4.5 中国晶圆代工国际地位

5.4.6 晶圆代工行业技术趋势

第六章 2021-2023年国外化学机械抛光（CMP）技术行业主要经营情况

6.1 美国应用材料（Applied Materials, Inc.）

6.1.1 企业发展概况

6.1.2 2021财年企业经营状况分析

6.1.3 2022财年企业经营状况分析

6.1.4 2023财年企业经营状况分析

6.2 荏原株式会社

6.2.1 企业发展概况

6.2.2 2021年企业经营状况分析

6.2.3 2022年企业经营状况分析

6.2.4 2023年企业经营状况分析

6.3 卡博特公司

6.3.1 企业发展概况

6.3.2 2021财年企业经营状况分析

6.3.3 2022财年企业经营状况分析

6.3.4 2023财年企业经营状况分析

6.4 陶氏公司

6.4.1 企业发展概况

6.4.2 2021年企业经营状况分析

6.4.3 2022年企业经营状况分析

6.4.4 2023年企业经营状况分析

第七章 2020-2023年国内化学机械抛光（CMP）技术行业主要经营情况

7.1 华海清科股份有限公司

7.1.1 企业发展概况

7.1.2 企业产品布局

7.1.3 经营效益分析

7.1.4 企业营收结构

7.1.5 业务经营分析

7.1.6 财务状况分析

7.1.7 企业项目投资

7.1.8 企业技术水平

7.1.9 核心竞争力分析

7.1.10 公司发展战略

7.1.11 未来前景展望

7.2 湖北鼎龙控股股份有限公司

7.2.1 企业发展概况

7.2.2 企业产品布局

7.2.3 经营效益分析

7.2.4 企业营收结构

7.2.5 业务经营分析

7.2.6 财务状况分析

7.2.7 企业技术水平

7.2.8 企业项目投资

7.2.9 核心竞争力分析

7.2.10 公司发展战略

7.2.11 未来前景展望

7.3 安集微电子科技（上海）股份有限公司

7.3.1 企业发展概况

7.3.2 企业主要产品

7.3.3 产品产量规模

7.3.4 经营效益分析

7.3.5 企业营收结构

7.3.6 业务经营分析

7.3.7 财务状况分析

7.3.8 在研项目进展

7.3.9 项目投资动态

7.3.10 核心竞争力分析

7.3.11 公司发展战略

7.3.12 未来前景展望

7.4 北京晶亦精微科技股份有限公司

7.4.1 企业发展概况

7.4.2 企业竞争优势

7.4.3 企业竞争劣势

7.4.4 企业主要产品

7.4.5 产品演变历程

7.4.6 企业营收规模

7.4.7 企业营收结构

7.4.8 企业发展规划

第八章 化学机械抛光（CMP）技术行业项目投资案例

8.1 宁波安集化学机械抛光液建设项目

8.1.1 项目基本情况

8.1.2 项目投资必要性

8.1.3 项目投资可行性

8.1.4 项目投资概算

8.1.5 项目建设期限

8.1.6 项目经济效益

8.2 华海清科化学机械抛光机产业化项目

8.2.1 项目基本情况

8.2.2 项目投资价值

8.2.3 项目投资概算

8.2.4 项目效益分析

8.3 晶亦精微半导体装备项目

8.3.1 高端半导体装备研发项目

8.3.2 高端半导体装备工艺提升及产业化项目

8.3.3 高端半导体装备研发与制造中心建设项目

第九章 2023-2027年中国化学机械抛光（CMP）技术行业发展趋势及展望

9.1 CMP抛光材料行业发展趋势分析

9.1.1 行业发展前景

9.1.2 市场发展机遇

9.1.3 行业发展趋势

9.2 CMP设备行业发展趋势分析

9.2.1 行业发展前景

9.2.2 行业发展趋势

9.2.3 模块升级趋势

9.3 2023-2027年中国CMP技术行业预测分析

9.3.1 2023-2027年中国CMP技术行业影响因素分析

9.3.2 2023-2027年中国CMP设备销售规模预测

9.3.3 2023-2027年中国CMP材料市场规模预测

图表目录

图表1 CMP工艺原理图

图表2 中国CMP技术行业相关支持政策

图表3 电子化学品首批次应用示范指导目录

图表4 2018-2022年国内生产总值及其增长速度

图表5 2018-2022年三次产业增加值占国内生产总值比重

图表6 2022年GDP初步核算数据

图表7 2017-2022年GDP同比增长速度

图表8 2017-2022年GDP环比增长速度

图表9 2023年GDP初步核算数据

图表10 2017-2021年全部工业增加值及其增长速度

图表11 2021年主要工业产品产量及其增长速度

图表12 2021-2022年规模以上工业增加值同比增长速度

图表13 2022年规模以上工业生产主要数据

图表14 2022-2023年规模以上工业增加值同比增长速度

图表15 2023年规模以上工业生产主要数据

图表16 2022年年末人口数及其构成

图表17 2012-2022年全国60周岁及以上老年人口数量及占全国总人口比重

图表18 2012-2022年全国65周岁及以上老年人口数量及占全国总人口比重

图表19 2012-2021年全国65周岁及以上老年人口抚养比

图表20 2021年居民人均可支配收入平均数与中位数

图表21 2022年全国及分城乡居民人均可支配收入与增速

图表22 2023年全国及分城乡居民人均可支配收入与增速

图表23 2021年居民人均消费支出及构成

图表24 2022年居民人均消费支出及构成

图表25 2023年居民人均消费支出及构成

图表26 各类平坦化技术与CMP平坦化效果

图表27 CMP技术的优点

图表28 当前各CMP厂商工艺水平

图表29 2015-2023年化学机械抛光全球申请趋势

图表30 1965-2022年各国化学机械抛光专利申请趋势

图表31 全球CMP专利地域分布情况

图表32 化学机械抛光创新主体专利申请量

图表33 半导体材料主要细分产品

图表34 三代半导体材料发展历程及主要特征

图表35 2021-2022年全球半导体材料市场规模

图表36 抛光材料分类状况

图表37 CMP广泛应用于硅片、芯片制造与前端封装工艺

图表38 随着制程向先进化发展，对表面平坦化程度的要求提升

图表39 逻辑类制程中CMP工序道数

图表40 NAND类存储从2D到3D，CMP道数翻倍以上增长

图表41 CMP抛光材料产业链

图表42 2021-2023年全球CMP材料市场规模统计

图表43 2021年全球CMP材料市场规模及占比

图表44 CMP发展史

图表45 2017-2023年中国CMP抛光材料行业市场规模预测及增速

图表46 CMP细分抛光材料市场份额

图表47 截至2023年全球CMP抛光液产业专利申请数量Top10申请人

图表48 安集科技产品立项周期

图表49 抛光液主要成分和作用

图表50 常见被抛光材料研磨液组分

图表51 CMP抛光液细分成分

图表52 按照研磨颗粒划分的CMP抛光液类别

图表53 2017-2028年中国CMP抛光液市场规模

图表54 中国CMP抛光液行业市场竞争梯队

图表55 2020-2021年中国CMP抛光液行业市场份额

图表56 2016-2021年安集科技CMP抛光液全球市场占有率变化

图表57 中国与国际CMP抛光液企业业务对比情况

图表58 中国CMP抛光液企业业务布局及竞争力评价

图表59 中国CMP抛光液行业国产替代驱动因素

图表60 CMP抛光垫参数和对抛光的影响

图表61 CMP抛光垫种类和特点

图表62 CMP抛光垫的参数指标

图表63 2015-2021年中国抛光垫产量及需求量变化情况

图表64 2016-2021年中国CMP抛光垫市场规模

图表65 2015-2021年中国抛光垫销售均价走势图

图表66 国内外抛光垫主要生产企业

图表67 半导体设备所在环节

图表68 半导体设备的分类

图表69 半导体设备产业链示意图

图表70 半导体设备细分领域代表性企业分布

图表71 中国半导体设备行业发展历程

图表72 中国半导体设备政策发展历程

图表73 国家层面有关半导体设备的政策重点内容

图表74 国家层面有关半导体设备的政策重点内容（续）

图表75 “十四五”规划对半导体设备产业的重点规划内容

图表76 2017-2023年中国半导体设备市场规模统计

图表77 半导体设备细分产品市场占比情况

图表78 2022年中国半导体设备行业上市企业基本信息

图表79 2021年中国半导体设备行业企业业务布局及竞争力评价

图表80 主要半导体设备国产化率及供应商

图表81 2018-2023年中国半导体设备投资情况统计

图表82 2023年中国半导体设备行业投融资情况汇总

图表83 中国半导体设备行业发展趋势

图表84 2018-2022年全球CMP设备市场规模变化

图表85 全球CMP设备市场区域结构占比情况

图表86 全球CMP设备市占率

图表87 CMP在半导体工艺中的应用

图表88 CMP设备应用场景

图表89 2017-2022年中国CMP设备市场规模变化趋势

图表90 2015-2022年中国CMP设备进出口数量

图表91 2015-2022年中国CMP设备进出口金额

图表92 2021年我国CMP设备进口来源地进口额分布

图表93 CMP设备各供应商对比

图表94 晶圆加工过程示意图

图表95 2017-2022年全球集成电路市场规模

图表96 2021年全球集成电路产品细分市场占比情况

图表97 2021年全球IC企业市场份额区域分布

图表98 2020-2021年全球半导体厂商营收排名

图表99 2022年全球排名半导体厂商收入

图表100 2017-2022年晶圆制造市场总销售额与增长率

图表101 2021年全球大代工厂商晶圆产能情况一览

图表102 2021年晶圆产能按不同尺寸分布比例

图表103 不同晶圆尺寸不同工艺制程的下游应用领域

图表104 全球主要晶圆厂产能扩充情况

图表105 2017-2022年中国集成电路制造业销售额

图表106 集成电路制造设备分类

图表107 2019-2025年全球半导体行业资本开支及集成电路晶圆加工设备市场规模

图表108 半导体IC制造行业壁垒分析

图表109 2017-2023年全球晶圆代工销售额情况

图表110 2019-2023年全球新建晶圆厂数量趋势图

图表111 2022年全球大晶圆代工厂营收排名

图表112 2023年全球大晶圆代工企业排名

图表113 2017-2023年中国大陆晶圆代工行业市场规模

图表114 2017-2026年中国大陆纯代工市场占比趋势图

图表115 2020-2021财年应用材料公司综合收益表

图表116 2020-2021财年应用材料公司分部资料

图表117 2020-2021财年应用材料公司收入分地区资料

图表118 2021-2022财年应用材料公司综合收益表

图表119 2021-2022财年应用材料公司分部资料

图表120 2021-2022财年应用材料公司收入分地区资料

图表121 2022-2023财年应用材料公司综合收益表

图表122 2022-2023财年应用材料公司分部资料

图表123 2022-2023财年应用材料公司收入分地区资料

图表124 2020-2021年荏原株式会社综合收益表

图表125 2021-2021年荏原株式会社分部资料

图表126 2020-2021年荏原株式会社收入分地区资料

图表127 2021-2022年荏原株式会社综合收益表

图表128 2021-2022年荏原株式会社分部资料

图表129 2021-2022年荏原株式会社收入分地区资料

图表130 2022-2023年荏原株式会社综合收益表

图表131 2022-2023年荏原株式会社分部资料

图表132 行业Cabot覆盖抛光液产品众多

图表133 2020-2021财年卡博特综合收益表

图表134 2020-2021财年卡博特收入分地区资料

图表135 2021-2022财年卡博特综合收益表

图表136 2021-2022财年卡博特收入分地区资料

图表137 2022-2023财年卡博特综合收益表

图表138 2022-2023财年卡博特收入分地区资料

图表139 2020-2021年陶氏公司综合收益表

图表140 2020-2021年陶氏公司分部资料

图表141 2020-2021年陶氏公司收入分地区资料

图表142 2021-2022年陶氏公司综合收益表

图表143 2021-2022年陶氏公司分部资料

图表144 2021-2022年陶氏公司收入分地区资料

图表145 2022-2023年陶氏公司综合收益表

图表146 2022-2023年陶氏公司分部资料

图表147 2022-2023年陶氏公司收入分地区资料

图表148 华海清科股份发展历程

图表149 华清海科主要产品介绍

图表150 2020-2023年华海清科股份有限公司总资产及净资产规模

图表151 2020-2023年华海清科股份有限公司营业收入及增速

图表152 2020-2023年华海清科股份有限公司净利润及增速

图表153 2017-2022年华清海科分业务收入

图表154 2017-2021年CMP设备销售数量

图表155 2022年华海清科股份有限公司主营业务分行业、产品、地区、销售模式

图表156 2020-2023年华海清科股份有限公司营业利润及营业利润率

图表157 2020-2023年华海清科股份有限公司净资产收益率

图表158 2020-2023年华海清科股份有限公司短期偿债能力指标

图表159 2020-2023年华海清科股份有限公司资产负债率水平

图表160 2020-2023年华海清科股份有限公司运营能力指标

图表161 华海清科公开公开发行股票募集资金用途

图表162 公司CMP产品应用情况及国际先进水平

图表163 华海清科在研CMP项目

图表164 鼎龙股份发展历程

图表165 鼎龙股份主要产品及用途

图表166 2020-2023年湖北鼎龙控股股份有限公司总资产及净资产规模

图表167 2020-2023年湖北鼎龙控股股份有限公司营业收入及增速

图表168 2020-2023年湖北鼎龙控股股份有限公司净利润及增速

图表169 2018-2022年鼎龙股份收入拆分（按产品）

图表170 2018-2022年鼎龙股份主要产品毛利率情况

图表171 2021-2022年湖北鼎龙控股股份有限公司营业收入分行业、产品、地区

图表172 2020-2023年湖北鼎龙控股股份有限公司营业利润及营业利润率

图表173 2020-2023年湖北鼎龙控股股份有限公司净资产收益率

图表174 2020-2023年湖北鼎龙控股股份有限公司短期偿债能力指标

图表175 2020-2023年湖北鼎龙控股股份有限公司资产负债率水平

图表176 2020-2023年湖北鼎龙控股股份有限公司运营能力指标

图表177 鼎龙股份CMP制程材料进度及产能情况

图表178 鼎龙股份抛光液项目进度

图表179 安集科技发展沿革

图表180 安集科技产品布局

图表181 2018-2022年安集科技两大类产品产量统计

图表182 2020-2023年安集微电子科技（上海）股份有限公司总资产及净资产规模

图表183 2020-2023年安集微电子科技（上海）股份有限公司营业收入及增速

图表184 2020-2023年安集微电子科技（上海）股份有限公司净利润及增速

图表185 2022年安集科技核心业务营收状况

图表186 2022年安集科技毛利结构

图表187 2022年安集微电子科技（上海）股份有限公司主营业务分行业、产品、地区、销售模式

图表188 2020-2023年安集微电子科技（上海）股份有限公司营业利润及营业利润率

图表189 2020-2023年安集微电子科技（上海）股份有限公司净资产收益率

图表190 2020-2023年安集微电子科技（上海）股份有限公司短期偿债能力指标

图表191 2020-2023年安集微电子科技（上海）股份有限公司资产负债率水平

图表192 2020-2023年安集微电子科技（上海）股份有限公司运营能力指标

图表193 安集科技在研项目进展

图表194 安集科技募集投资项目及投入进度

图表195 2022年安集科技拟募集资金投资项目

图表196 晶亦精微CMP设备产品类型

图表197 公司主要产品演变情况

图表198 2022年晶亦精微主要业务指标

图表199 2022年晶亦精微营收分布

图表200 宁波安集化学机械抛光液建设项目投资概算

图表201 宁波安集化学机械抛光液建设项目实施进度

图表202 华海清科高端半导体装备（化学机械抛光机）产业化项目投资概算

图表203 高端半导体装备研发项目投资估算

图表204 高端半导体装备工艺提升及产业化项目投资估算

图表205 高端半导体装备研发与制造中心建设项目投资估算

图表206 CMP抛光材料发展趋势

图表207 CMP设备模块升级趋势

图表208 2023-2027年中国CMP设备销售规模预测